

半導体用ウエットエッチング剤 界面活性剤入り バッファードフッ酸 BHF-U シリーズ

 TECHNICAL
DATASHEET

ウエットエッチング剤 界面活性剤入りバッファードフッ酸 BHF-U シリーズは、フッ化水素酸とフッ化アンモニウムの混合品に独自の界面活性剤を添加したタイプです。

概要

- 半導体製造向けに金属イオン等の不純物を大幅に低減した高品質なエッチング剤です。
- BHF シリーズと同様にフッ化水素酸とフッ化アンモニウムの混合比率により、エッチングレートや選択比のコントロールが可能です。
- 界面活性剤の添加により、濡れ性の向上、Poly-Si のエッチング抑制、ウエハ上への粒子付着の低減、Si 表面の粗れの防止が可能です。

一般物性

項目	単位	数値
HF 濃度	mass%	混合比による
NH ₄ F 濃度	mass%	混合比による

【検査項目】

- アニオン系物質、金属イオン、微粒子
- 個別の品質につきましては、お問い合わせ下さい。

取扱方法／安全情報

- ご使用前に SDS とラベルに記載の注意事項を必ずお読み下さい。
- 当製品は、工業用途として開発されたもので、それ以外の使用について、その安全性を保証するものではありません。医療用途、食品用途などにお使いの場合は、当社まで事前にご連絡下さい。

梱包仕様

- 5Kg、20Kg、100Kg、1000kg

For more information, visit our website.

ダイキン工業株式会社

<https://www.daikinchemicals.com/jp>

tds-bhf-u-J_ver01_Aug_2019
Copyright (C) DAIKIN INDUSTRIES, LTD., 2019